

证券代码：605358

证券简称：立昂微



杭州立昂微电子股份有限公司

2020 年度股东大会

会议资料

2021 年 4 月 28 日

目 录

杭州立昂微电子股份有限公司 2020 年度股东大会会议须知	2
杭州立昂微电子股份有限公司 2020 年度股东大会会议议程	4
一、 关于 2020 年度董事会工作报告的议案	6
二、 关于 2020 年度监事会工作报告的议案	17
三、 关于<公司 2020 年年度报告>及其摘要的议案	21
四、 关于公司 2020 年度财务决算报告的议案	22
五、 关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案	28
六、 关于公司 2020 年度利润分配预案的议案	29
七、 关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案	32
八、 关于 2020 年度公司董事、监事薪酬的议案	33
九、 关于公司及子公司 2021 年度申请银行贷款授信额度的议案	34
十、 关于公司 2021 年度为控股子公司的银行授信提供担保的议案	35
十一、 关于续聘 2021 年度审计机构的议案	36

杭州立昂微电子股份有限公司

2020 年度股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保杭州立昂微电子股份有限公司 2020 年度股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，现将会议须知通知如下：

一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务；

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处；

三、股东到达会场后，请首先到签到处签到。股东签到时，请出示以下证件和文件：

1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）等能证明其法定代表人身份的有效证明、持股凭证和法人股东股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、持股凭证和法人股东股票账户卡；

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股票账户卡等能证明其身份的有效证明；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人股票账户卡等有效身份证明。

四、股东参加本次大会依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利；

五、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每人每次不超过三分钟，同一股东或股东代理人发言不超过两次。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言；

六、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决；

七、参会人员进入会场后，请关闭手机或调至静音、震动状态，不得大声喧哗；谢绝在会议现场个人录音、录像及摄影，维护每位参会人员权益；

以上会议须知内容，望参加本次临时股东大会的全体人员务必严格遵守。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

杭州立昂微电子股份有限公司 2020 年度股东大会会议议程

现场会议时间：2021 年 4 月 28 日下午 2 时

网络投票时间：2021 年 4 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：浙江省杭州经济技术开发区 20 号大街 199 号杭州立昂微电子股份有限公司办公楼二楼多功能会议室

会议召集人：公司董事会

主要议程：

- 一、主持人宣布会议开始，并介绍出席情况；
- 二、宣读会议须知；
- 三、审议会议议案：
 - 1、《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》；
 - 2、《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》；
 - 3、《关于〈公司 2020 年年度报告〉及其摘要的议案》；
 - 4、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》；
 - 5、《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》；
 - 6、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》；
 - 7、《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
 - 8、《关于 2020 年度公司董事、监事薪酬的议案》；
 - 9、《关于公司及子公司 2021 年度申请银行贷款授信额度的议案》；
 - 10、《关于公司 2021 年度为控股子公司的银行授信提供担保的议案》；
 - 11、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》。

四、确定大会计票人、监票人；

五、股东及股东代理人投票表决；

六、工作人员向上证所信息网络有限公司上市公司服务平台上传现场会议投票表决结果，下载合并后的投票表决结果；

七、主持人宣读表决结果及股东大会决议；

八、律师宣读本次股东大会的法律意见；

九、签署会议记录及会议决议；

十、主持人宣布会议结束。

一、关于 2020 年度董事会工作报告的议案

报告人 王敏文

各位股东：

现在我受公司董事会的委托，向大家报告 2020 年度公司董事会的工作情况和 2021 年度公司董事会的工作计划，报告内容如下：

一、2020 年度工作回顾

（一）概述

这是一个充满变数的年份，也是一个先抑后扬的年份。面对严峻复杂、对抗性加剧的全球政治形势带来的全球经济波动，与新冠疫情的严重冲击，公司经营班子在董事会的正确决策领导下，带领全体员工准确判断形势、精心谋划部署，转危为机，应对市场变化，满足市场需求，发挥产业链一体化联动优势，有效组织生产，推进目标实施，经过艰苦的努力，在抗击大风险中紧紧抓住了发展大机遇，取得了来之不易的经营业绩，交出了一份在公司发展历史上少见的靓丽答卷。

报告期内，公司实现合并销售 150,202 万元，同比增长 26.04%；实现合并营业利润 23,915 万元，同比增长 37.53%；合并归属于母公司所有者的净利润 20,196 万元，较上年同期增长 57.54%。报告期末，公司总资产 63.75 亿元，较期初增长 34.00%；归属于上市公司股东的净资产为 18.55 亿元，较期初增长 22.55%。

影响公司报告期业务的主要因素有：

（1）随着疫情带来的宅经济增长，以及智能经济快速发展带动的下游需求持续增加，2020 年公司所处半导体行业市场景气度不断提升，到下半年可以用“火爆”来形容也不为过，加以国外疫情近乎失控的乱局导致了半导体产业加速向东亚特别是中国转移，公司产业链一体化优势与规模效应优势进一步得以发挥，市场占有率稳步攀升；

（2）半导体功率器件产品的应用端光伏清洁能源行业、新能源汽车行业市场景气度也有显著提升，对公司生产的高端器件产品的需求持续增加，虽然产能有较大提升，但仍难以满足市场的旺盛需求，供不应求态势明显，也直接抬升了

市场占有量；

(3) 公司之前较早布局且完成了 6 英寸、8 英寸硅片新产线建设，半导体功率器件产线的产能技改提升，恰逢其时，较为充分地满足了不断趋热的市场需求，近期建成的 12 英寸硅片产线与射频芯片产线也迎来了较好的市场机遇，开始了商业化量产销售；

(4) 现有的半导体硅片、半导体功率器件产线通过工艺技术创新、管理提升和精益化生产，在技术改进、产品结构优化、良率提升和成本控制等方面成果显著，有效提升了产能与品质，与市场需求有较高的契合度；

(5) 即使这样，下半年半导体行业的市场需求形势出乎意料地旺盛，公司半导体硅片、半导体功率器件、射频芯片三大板块的既有产能还是远远不能完全满足客户需求，有待进一步加快产能提升，消除产能瓶颈。

2020 年是公司发展历史上具有里程碑意义的一年，根据证监会批准，经过长期的努力，公司于 2020 年 9 月 11 日在上海证券交易所主板 A 股成功挂牌上市，终于成功进入了资本市场。从此，公司将借助于资本市场的力量，借助于国家集成电路产业政策鼓励的东风，紧紧抓住难得的行业发展机遇，更加积极专注主业，完善产业链，谋求创新和发展，加快国产替代，解决“卡脖子”技术，全面提升竞争力，努力打造行业领先、国际一流的半导体行业领军企业。

为了实施“行业领先、国际一流”的发展战略，公司根据半导体行业发展态势及全球科技竞争不断加剧的局面，提出了未来三年公司的四大经营目标：一是实现 12 英寸硅片的产业化并不断提升产能，二是实现化合物半导体射频芯片的产业化，三是实现 8 英寸硅片的扩产，四是实现半导体功率器件产品的扩面、延伸、提升，从而形成半导体硅片、半导体功率器件、射频芯片三大业务互为支撑、三代半导体共同发展的产业链布局。同时，也提出了以“五年百亿”为主线的经营规划，加速发力项目新建、技术改造、产品研发，持续将企业做大做强，力争在不远的将来，公司能成为全球半导体行业举足轻重的卓越供应商。

(二) 主营业务分析

1、半导体硅片业务

2020 年半导体行业进入新一轮上升周期，半导体芯片市场需求较为强劲，进而带动了半导体硅片的市场需求。SEMI 在 2021 年 2 月发布的《硅晶圆产业年

末分析报告》称,2020 年全球硅晶圆出货面积总量接近 2018 年创下的历史纪录。公司作为国内半导体硅片领域的龙头企业, 半导体硅片营收取得较大幅度增长。

报告期内, 6 英寸硅片增速显著, 得益于国内经济的快速增长以及清洁能源、新能源汽车等需求爆发性增长, 同时, 人工智能、电子化应用的场景越来越多, 带动了对芯片、硅片的需求, 公司 6 英寸硅片产线长期处于满负荷运转状态, 特别是 6 英寸特殊规格的硅外延片更是供不应求。大尺寸硅片规模上量明显, 其中公司 8 英寸硅片产线的产能充分释放; 12 英寸硅片在关键技术、产品质量以及客户验证上取得重大突破, 已实现规模化生产销售, 目前主要销售的产品包括抛光片测试片及外延片正片, 同时正在持续开展客户送样验证工作, 预计将在 2021 年底达到年产 180 万片规模的产能。

2、半导体功率器件业务

2020 年全球光伏市场高速增长, 新能源汽车业务也蒸蒸日上, 这给公司的肖特基芯片、MOS 芯片等半导体功率器件业务的增长带来了极大的市场机遇。

报告期内, 公司的平面肖特基产品作为传统主打的应用于光伏的产品, 仍占有较大的市场份额, 但随着沟槽产品取代平面产品的趋势加快, 公司沟槽肖特基、MOS 产品借助光伏需求的增长在下半年销量也迅猛增长。应用于消费电子、汽车电子的半导体功率器件产品上半年生产、市场受限严重, 下半年市场反转, 需求前所未有的旺盛, 公司肖特基芯片、MOS 芯片的订单量远远超出了实际最大产能, 特别是 MOS 芯片的产销出现了爆发式增长。

3、化合物半导体射频芯片业务

近年来, 5G 通讯和智能手机的发展带动了砷化镓射频芯片的推广应用, 3D 识别、人工智能、无人驾驶、高端平面显示等新技术和新产品也给砷化镓射频芯片带来更大的发展空间。据分析, 2019—2024 年, 中国砷化镓元件市场 CAGR 在 15%左右, 快于全球市场同期增速, 中国市场规模占全球比重将进一步提升。

报告期内, 公司业务较去年有了较大发展, 在稳定核心客户的同时开发了新客户共计 30 多家, 但目前产线单一机台较多, 预期产能的发挥受到限制, 长期处于供不应求状态, 随着设备的填平补齐, 预计 2021 年将会达到预期产能, 有较大的产出与销售量。

(三) 核心竞争力分析

1、产业链上下游一体化优势。公司涵盖了从硅单晶拉制到硅抛光片、硅外延片，再到半导体功率器件等半导体行业上下游多个生产环节，形成了一条相对完整的半导体产业链。这有利于发挥产业链上下游整合的优势，贯通半导体硅片与半导体功率器件的上下游产业链，使公司能够从原材料端就开始进行质量控制与工艺优化，缩短研发验证周期，保障研发设计弹性，在保证盈利水平的同时抵御短期供需冲击。

2、行业先发优势和规模优势。公司成立于本世纪初，是我国较早一批专业从事半导体硅片和半导体功率器件研发、生产和销售的企业之一。多年来，公司一直专注于主营业务的开拓与发展，逐渐成为国内半导体硅片、半导体功率器件和化合物半导体射频芯片细分行业的具有头部优势的企业，在技术积累、经营管理、客户维系与开发等诸多方面，具有一定的先发优势。体现在生产环节，公司具有较高的产品档次和产销规模，生产具有一定的规模经济效应。体现在研发环节，公司较早拥有技术、人才储备，积累了丰富的研发经验。

3、自主知识产权技术与研发优势。公司一直将技术创新作为重要的发展战略，建立了较为完善的技术创新体系和科技激励机制。在多年积累的自主研发经验的基础上，公司形成了一套系统的研发管理标准，建立了包含市场需求分析、研发立项管理、实施与检查等多环节在内的研发流程体系。公司曾经承担并完成了包括“02 专项”在内的多项国家重大科技项目，曾获得多项国家及省部级技术发明奖。公司强大的技术储备、丰富的研发经验确保了自主研发的连续性与有效性，有效保障了产品稳定性与良率，面向客户具有较强的议价能力。

4、较强的人才团队优势。公司通过培养、引进集聚了众多的中、高级专业技术人才，拥有一支稳定的经验丰富、高度专业化的技术团队。主要研发人员具有在国内外知名半导体企业担任重要技术岗位的从业背景，形成了技术专家、技术骨干、技术后备力量为主体的多层次技术队伍，并拥有较为完善的技术层级和技术人才储备。在技术研发、控制工艺参数、提高产品良率与可靠性、产品质量管理上有着丰富的实践经验，具备较强的自主研发和创新能力。

5、较强的市场竞争力优势。半导体行业客户开发周期较长、供应商认证门槛较高，这归因于客户对产品的品质要求较高。一般需要长达半年以上的质量考察，才能确定是否选定为供应商。公司始终坚持高品质标准，在技术上充分满足

半导体行业高端客户的要求，产品长期供应日本东芝、美国安森美、中芯国际、华虹等众多国内外重大客户，还顺利通过了博世(Bosch)、大陆集团(Continental)等国际一流汽车电子客户的 VDA6.3 审核认证。高端客户的严苛要求和新的需求也更加推动了公司经营管理水平、质量管控水平的不断提高，更加有利于公司参与市场激烈竞争、巩固头部优势地位。

二、关于公司未来发展的展望

(一) 公司所处行业的发展趋势与公司面临的行业发展格局

根据美国半导体产业协会(SIA)统计数据：2020 年全球半导体产业销售额为 4,390 亿美元，与 2019 年的 4,123 亿美元相比增长了 6.5%。从各季度销售情况来看，第四季度全球半导体产业的销售额增长，抵消了 3、4 月份的大幅下滑。2020 年中国仍然是全球最大的芯片市场，其销售额总计 1,517 亿美元，与 2019 年相比增长了 5.0%。

从半导体行业整体情况看，全球市场在周期波动中持续增量发展，2020 年，在 5G 商用以及新冠疫情所催生的宅经济、云办公、线上教学等的影响下，应用端市场对芯片产品的需求意外地维持增长，年底时甚至出现了一轮缺货行情。进入 2021 年，半导体领域的缺货行情仍在延续，一方面半导体产业转移趋势加速，中国正在从最大的半导体消费国向最大的生产国转变，另一方面汽车电子、5G、AI、大数据、云计算已成为半导体市场新的增长引擎。根据 Gartner 数据统计及预测，2020 年，全球云计算市场规模超过 2200 亿美元。由此将对半导体产品形成巨大的采购需求。这种需求并将延续下去，预计至 2023 年市场规模将会达到约 3600 亿美元。5G 的应用也在不断扩展，应用场景不断落地，在未来 3—5 年都将持续放量，将有越来越多的设备被连网，其中蕴含了大量市场机会。汽车行业的智能化、电动化、网联化已经成为汽车产业不可逆转的趋势，驱动着 2021 年车用半导体市场的发展，即便汽车市场没有任何增量，每辆车内的半导体含量也会有 4 到 5 倍的增量，拓璞产业研究院预估，2021 年将达到 210 亿美元，年增长率达 12.5%。

从公司所处的国内行业来讲，来自美国等外部的打压不会减弱，但国家的产业政策以及地方政府的引导扶持也十分有力，行业热度的持续上升、资本市场的驱动或加持，行业发展机会在增多，行业队伍将会快速壮大，行业内的竞争也将

会加剧。一定要做行业的领先者，是公司的不二选择。

（二）公司面临的发展机遇

随着半导体国家产业政策的落实、“十四五”规划的开局、5G网络建设、新能源汽车快速发展、“碳达峰、碳中和”目标的提出，预计未来中国半导体产业将继续保持较快的增长态势。

公司经过二十年的发展，坚持走自主研发、自主创新之路，深耕半导体行业，在半导体硅片、半导体功率器件与化合物半导体射频芯片领域，具备一系列的核心竞争优势。近几年，公司通过承担国家科技重大专项、引进高端技术人才等多种方式，不断加大技术研发投入，加强技术积累，在新技术、新产品、新工艺上不断取得新的重大突破，为公司可持续发展增添了强劲动力。

公司于 2020 年 9 月 11 日在上交所主板 A 股成功挂牌上市，顺利进入资本市场，将会更加有利于公司借助资本市场的力量，加大投入，加快发展，将主业做大做强，让公司在正确的发展道路上快速奔跑。

（三）公司发展战略

公司坚定实施“专注主业，自主创新，追求行业领先，跻身国际一流”的发展战略

公司经过二十年的发展，已经形成了“以盈利的小尺寸半导体硅片产品带动大尺寸半导体硅片的研发和产业化，以成熟的半导体硅片业务、半导体功率器件业务带动化合物半导体射频芯片”的产业化模式，较好地兼顾了公司的盈利能力及未来的发展潜力，为公司的持续、快速发展打下了坚实的基础。

公司未来将继续在半导体行业聚精会神努力深耕，坚持自主研发与自主创新，积极谋求多层次、多领域的合作，力图攻克一批关键技术，突破国产替代瓶颈，达成公司发展战略目标。在半导体硅片方面，重点发展集成电路用 12 英寸硅片业务，着力开发适用于 40-14nm 集成电路制造用 12 英寸硅单晶生长、硅片加工、外延片制备等成套量产工艺，实现 12 英寸半导体硅片的国产化，打破我国 12 英寸半导体硅片基本依赖进口的局面。在半导体功率器件方面，一方面优化现有产品结构，扩大产能规模，巩固和拓展在光伏产业、消费电子等终端领域的应用，另一方面重点发力汽车电子市场，切实做好器件板块的延伸、扩面、提升，以增强公司半导体功率器件产品的抗风险能力。在化合物半导体射频芯片方面，重点

发展第二代半导体微波射频芯片业务，丰富和完善产品结构，并适当进行化合物半导体射频芯片业务的代际延伸，充分发挥资源整合优势，进一步提升公司的市场竞争力。

三、2021 年度经营计划

（一）经营业绩预计

公司预计 2021 年实现营业总收入 202,706 万元(比 2020 年增长 35%左右)，营业总成本 166,607 万元（比 2020 年增长 32%左右）。

上述预计不构成本公司的盈利预测，其实现具有不确定性。

（二）资本性支出预计

公司预计 2021 年资本性支出 36.8 亿元，其中年产 180 万片集成电路用 12 英寸半导体硅片项目产能建设预计支出 21.8 亿元，年产 72 万片 6 英寸半导体功率器件项目产能建设预计支出 6.3 亿元，年产 240 万片 6 英寸半导体硅外延片技术改造项目及 8 英寸半导体硅片技术改造项目预计支出 5.5 亿元，年产 7 万片化合物半导体射频芯片产能建设预计支出 3.2 亿元。资金主要来源于公司再融资资金及自有资金。

（三）经营工作计划：

1、**半导体硅片**——计划在 2021 年完成衢州基地 8 英寸、12 英寸生产线的扩建工程，确保明年初按时实现投产，以加快其产业化进程；加大现有宁波基地、衢州基地 6 英寸生产线的技术改造，进一步扩充产能。

2、**半导体功率器件**——通过内部挖潜与技术改造，继续有效推进半导体功率器件的产能提升，重点提高沟槽产品的生产能力与市场占有率，强化巩固公司在光伏芯片领域的领先地位，并快速提高通用电源高端客户产品总量的比例。

3、**化合物半导体射频芯片**——年内完成年产 7 万片的砷化镓射频芯片产能建设，并达到全年预定的出货销售目标；认真做好前期筹建工作，启动海宁化合物集成电路芯片项目一期建设工程。

（四）公司面临的风险和应对之道

1、行业需求的风险

半导体行业的需求与下游终端应用领域行业的景气度密切相关。目前，新能源汽车、人工智能、物联网等新兴产业的快速发展作为半导体行业新的需求增长

点，为公司半导体硅片、半导体功率器件、化合物半导体射频芯片业务提供了巨大的市场增长空间。但如果未来一旦半导体行业下游终端应用领域行业的市场需求出现衰减，将导致公司主营业务无法保持持续增长，从而导致公司经营业绩出现波动。

公司在经营发展过程中，需要未雨绸缪，运用底线思维，精准把握半导体行业周期，做好行业需求变动的对策，以更好地避免行业需求变动带来的风险。

2、市场竞争的风险

近年来，受益于通信、计算机、汽车电子、消费电子、光伏新能源、智能电网、医疗电子等终端应用领域的快速发展以及 5G、人工智能、物联网等新兴产业的快速崛起，极大地提高了半导体行业的市场景气度，同时西方国家对中国半导体企业的打压，普及了国人对半导体在中国发展现状的认知，国家及各地政府对半导体产业扶持政策的相继出台，以及资本市场的驱动，不断诱发新的行业参与者进入，虽然半导体行业有较高的技术、人才、资金壁垒，不少属于无效或低效进入，但不加规制，一定程度上还是会导致行业过度竞争，甚至无序竞争。

公司需要坚持“行业领先、国际一流”的战略定位，正确判断行业发展动态和市场需求变化，加强人才队伍建设，加大技术研发投入，推动产品升级换代，优化产品结构与客户结构，以确保公司在日益激烈的市场竞争中立于不败之地。

3、技术迭代的风险

全球半导体行业的先进技术仍被欧美、日韩及台湾地区的少数企业垄断，而且技术迭代非常快速，国内半导体企业通过自主研发、引进吸收等方式已经取得了很大进步，但与全球先进企业相比仍然存在较大差距。目前，在半导体硅片领域，公司的工艺技术水平在国内同行中处于领先地位；在半导体功率器件领域，公司的传统优势产品肖特基二极管芯片在业内也具有较强的市场竞争力；在化合物半导体射频芯片领域，公司通过持续的研发投入，也已取得了核心技术方面的突破，开始实现规模化量产和销售。但如果未来公司在三大业务板块的技术研发与革新速度不能及时跟上国内企业对标国际领先水平的追赶节奏，或者不能快速将行业的新技术运用于产品的开发和升级，公司与国际先进技术水平差距将会进一步拉大，长此以往，将有被技术淘汰的风险。

公司需要不断地高度重视技术队伍建设，加大技术研发投入，坚持自主创新

与发展，努力赶超先进技术水平，进一步强化企业的核心竞争力。

四、董事会日常工作情况及股东大会决议执行情况

报告期内，董事会认真履行职责，行使好《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合实际经营工作需要，分别召开了十一次董事会会议和四次股东大会会议，会议的通知、召开、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的要求。主要情况如下：

（一）董事会会议情况及决议内容

报告期内，公司共召开了 11 次董事会会议，具体情形如下：

公司第三届董事会第十一次会议于 2020 年 3 月 16 日上午在公司行政会议室召开，会议审议通过了《关于公司 2019 年度审计报告的议案》一项议案；

公司第三届董事会第十二次会议于 2020 年 4 月 24 日上午在公司行政会议室召开，会议审议通过了《关于公司 2019 年度经营总结和 2020 年度经营计划的议案》、《关于公司董事会 2019 年度工作报告和 2020 年度工作计划的议案》、《关于公司 2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》、《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》、《关于公司管理层 2019 年度业绩奖励的议案》、《关于公司 2020 年度融资计划的议案》、《关于公司 2020 年度为子公司的银行授信提供担保的议案》、《关于聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构的议案》、《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》等十项议案；

公司第三届董事会第十三次会议于 2020 年 6 月 24 日上午十时在公司行政会议室召开，会议审议通过了《关于控股子公司增资 13 亿元暨关联交易的议案》、《关于公司申请银行综合授信的议案》、《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》等三项议案；

公司第三届董事会第十四次会议于 2020 年 7 月 2 日上午十时在公司行政会议室召开，会议审议通过了《关于公司 2020 年第一季度审计报告的议案》、《关于公司执行新收入准则并变更相关会计政策的议案》等两项议案；

公司第三届董事会第十五次会议于 2020 年 8 月 27 日上午十时在公司行政会议室召开，会议审议通过了《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金专户存储三方监管协议的议案》一项议案；

公司第三届董事会第十六次会议于 2020 年 9 月 11 日上午十一时在上海道铭控股有限公司行政会议室（上海市浦东新区灵山路 1 号天鑫大厦三楼）召开，会议审议通过了《关于增加公司注册资本及修改公司章程的议案》、《关于以募集资金向金瑞泓科技（衢州）有限公司借款实施募投项目的议案》、《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》等四项议案；

公司第三届董事会第十七次会议于 2020 年 9 月 28 日上午十时在公司行政会议室以通讯方式召开，会议审议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度的议案》、《关于公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》等两项议案；

公司第三届董事会第十八次会议于 2020 年 10 月 8 日上午十时在公司行政会议室以通讯方式召开，会议审议通过了《关于控股子公司及其股东拟与增资方签订增资交易文件的议案》、《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》等两项议案；

公司第三届董事会第十九次会议于 2020 年 10 月 26 日上午十时在公司行政会议室以通讯方式召开，会议审议通过了《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》一项议案；

公司第三届董事会第二十次会议于 2020 年 10 月 29 日上午十时在公司行政会议室以通讯方式召开，会议审议通过了《关于聘任汪耀祖先生担任公司副总经理的议案》一项议案；

公司第三届董事会第二十一次会议于 2020 年 12 月 31 日上午十时在公司行政会议室以通讯方式召开，会议审议通过了《关于公司与浙江省海宁市人民政府、浙江省海宁经济开发区管理委员会签订〈微波射频集成电路芯片项目投资协议书〉的议案》、《关于公司在海宁市成立微波射频集成电路芯片项目公司的议案》等两项议案；

报告期内，现任董事以现场或通讯方式出席了董事会会议，与会董事均能认真审议各项议案，并按照公司章程规定的权限作出了有效的表决。

（二）股东大会会议决议执行情况

报告期内，公司共召集召开年度股东大会一次，临时股东大会三次，具体召

开情况如下：

公司 2019 年度股东大会，于 2020 年 5 月 15 日下午二时在公司多功能会议室召开。会议审议通过了《关于公司董事会 2019 年度工作报告和 2020 年度工作计划的议案》、《关于 2019 年度公司监事会工作报告的议案》、《关于公司 2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告的议案》、《关于 2019 年度公司独立董事述职报告的议案》、《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》、《关于公司 2020 年度融资计划的议案》、《关于公司 2020 年度为子公司的银行授信提供担保的议案》、《关于聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构的议案》等八项议案；

公司 2020 年第一次临时股东大会，于 2020 年 7 月 9 日下午三时在公司多功能会议室召开。会议审议通过了《关于控股子公司增资 13 亿元暨关联交易的议案》、《关于公司申请银行综合授信的议案》等两项议案；

公司 2020 年第二次临时股东大会，于 2020 年 9 月 28 日下午二时在公司多功能会议室召开。会议审议通过了《关于增加公司注册资本及修改公司章程的议案》等一项议案；

公司 2020 年第三次临时股东大会，于 2020 年 10 月 29 日下午二时在公司多功能会议室召开。会议审议通过了《关于控股子公司及其股东拟与增资方签订增资交易文件的议案》等一项议案；

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，报告期内，各专门委员会依照《公司章程》及各自工作规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就专业性的事项进行研究，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。

以上议案，请予审议。

二、关于 2020 年度监事会工作报告的议案

报告人 陈卫忠

各位股东：

2020 年度，公司全体监事严格按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关法律法规的要求，本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行了自身职责。监事会对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督和检查，维护了公司及股东的合法权益。现受公司监事会委托，向大会报告 2020 年度监事会工作情况及 2021 年度监事会工作计划。

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了四次会议，具体情形如下：

2020 年 4 月 24 日下午 1:30，公司第三届监事会第四次会议在公司行政会议室召开。应参加会议的监事 3 人，给监事共发出表决票 3 张，实际收回有效表决票 3 张。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于公司 2019 年度经营总结和 2020 年度经营计划的议案》、《关于公司 2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》、《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》。

2020 年 6 月 24 日上午 10:00，公司第三届监事会第五次会议在公司行政会议室以通讯方式召开。应参加会议的监事 3 人，给监事共发出表决票 3 张，实际收回有效表决票 2 张，其中监事周诗雨因涉及关联交易回避表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于控股子公司增资 13 亿元暨关联交易的议案》。

2020 年 9 月 11 日上午 11:00，公司第三届监事会第六次会议在上海道铭控股有限公司会议室行政会议室(上海市浦东新区灵山路 1 号天鑫大厦三楼)召开。应参加会议的监事 3 人，给监事共发出表决票 3 张，实际收回有效表决票 3 张。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于

公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

2020 年 10 月 26 日上午 10:30，公司第三届监事会第七次会议在公司行政会议室以通讯方式召开。应参加会议的监事 3 人，给监事共发出表决票 3 张，实际收回有效表决票 3 张。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》。

二、监事会对 2020 年度工作的核查意见

2020 年监事会从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行职责，对公司的依法运作情况、公司经营、财务状况、履职守法情况进行了全面的检查监督。经认真审议一致认为：

（一）公司依法运作情况

监事会成员列席了本年度召开的股东大会、董事会会议，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的执行情况以及对公司管理制度的执行情况等进行了监督。会议的通知、召集、股东和董事出席情况、审议事项及表决结果等均符合法律规定的程序，各次会议所作决议均符合法律、法规和《公司章程》的规定，未发现有损害公司和股东利益的情况。

监事会认为，公司决策科学合理、程序合法，公司建立了较为完善的内部控制制度。公司董事和高级管理人员尽职勤责，忠诚勤勉，未发现有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司与股东利益的行为。

（二）公司财务情况

报告期内，公司监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了监督检查并审核报告期内公司董事会提交的财务决算报告，认为公司财务状况良好，财务制度健全、内控机制基本健全、会计无重大遗漏和虚假记载。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告，该报告真实、客观地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果。

（三）募集资金使用和管理情况

公司监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》以及上海证券交易所有关法律法规的规定，对募集资金进行使用和

管理，确保募集资金的安全存管和规范使用，不存在违规使用募集资金的情形。

（四）公司对外担保情况及股权、资产置换情况

公司监事会审核了报告期内发生的对外担保情况，认为公司无合并报表外的对外担保，公司在加强对控股子公司业务监管等情况下，对公司的担保总额、被担保企业的范围和提供贷款的银行作出了符合实际情况的规定，为控股子公司提供融资担保，增强了公司的活力，从而保护了公司及股东的利益。

报告期内，公司未发生股权、资产置换情况，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（五）公司关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易定价公平合理，决策程序合法合规，相关信息披露及时充分，未发现有损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。

（六）对 2020 年年度报告的审核意见

公司监事会对公司 2020 年年度报告进行了审核，认为公司董事会编制的审核的 2020 年年度报告的程序符合法律、法规和规范性文件的规定，报告内容客观、真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（七）对内部控制自我评价报告的意见

监事会对董事会关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设情况和运行情况进行了审核，认为：公司已基本建立了较为完善的内部控制制度体系，符合国家有关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效的执行。《2020 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对评价报告无异议。

三、监事会 2021 年工作计划

2021 年公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司的规范运作，对公司董事、高级管理人员履职情况，公司股东大会、董事会运行情况及公司日常经营等方面进行监督，督促公司进一步完善法人治理结构，促进公司治理水平持续提升。按照《公司监事会议事规则》的规定，定期组织召开监事会会议， 继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和决策程序的合法性和合规性，切实维护公司全

体投资者的合法利益，促进公司健康、持续发展。

以上议案，请予审议。

三、关于<公司 2020 年年度报告>及其摘要的议案

报告人 吴能云

各位股东：

由公司董事会负责编制的《杭州立昂微电子股份有限公司 2020 年年度报告》已经编制完成，现将《年度报告》及其摘要提交股东大会审议。具体内容详见附件一、二。

以上议案，请予审议。

附件一：《杭州立昂微电子股份有限公司2020年年度报告》

附件二：《杭州立昂微电子股份有限公司2020年年度报告摘要》

四、关于公司 2020 年度财务决算报告的议案

报告人 吴能云

各位股东：

公司 2020 年财务报表已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的 2020 年度审计报告，报告具体内容详见附件。现在我向大家汇报公司 2020 年度的财务决算相关情况如下：

一、主要会计数据

单位：万元人民币

项目	2020 年	2019 年	增减变动幅度
营业收入	150,201.78	119,168.60	26.04%
营业成本	97,188.82	74,701.84	30.10%
营业利润	23,915.55	17,389.92	37.53%
归属上市公司股东的净利润	20,195.77	12,818.79	57.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,019.28	8,579.38	75.06%
经营活动产生的现金流量净额	30,997.34	38,333.01	-19.14%
期末总股本（万股）	40,058.00	36,000.00	11.27%
资产总额	637,534.63	475,745.98	34.01%
负债总额	386,265.28	279,839.61	38.03%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益	185,532.86	151,390.24	22.55%

二、主要财务指标

项目	2020 年	2019 年	增减变动幅度
基本每股收益（元/股）	0.55	0.36	52.78%
稀释每股收益（元/股）	0.55	0.36	52.78%
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	0.41	0.24	70.83%
加权平均净资产收益率	12.28%	8.77%	3.51%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	9.13%	5.87%	3.26%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.84	1.06	-21.35%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.63	4.21	10.14%
资产负债率	60.59%	58.82%	1.77%

三、会计报表主要项目的说明

1、资产构成及变动情况

单位：万元人民币

项目	2020 年末	2019 年末	变动额	增减变动比率
货币资金	162,511.25	65,849.81	96,661.44	146.79%
应收票据	2,355.80	1,431.23	924.57	64.60%
应收账款	54,026.52	41,259.91	12,766.61	30.94%
应收款项融资	12,824.02	10,150.55	2,673.47	26.34%
预付款项	2,866.32	778.40	2,087.92	268.23%
其他应收款	835.16	1,653.54	-818.38	-49.49%
存货	51,628.28	42,999.16	8,629.11	20.07%
其他流动资产	9,743.74	15,525.78	-5,782.04	-37.24%
流动资产合计	296,791.09	179,648.39	117,142.70	65.21%
固定资产	263,870.55	216,947.88	46,922.67	21.63%
在建工程	15,676.79	60,351.35	-44,674.56	-74.02%
无形资产	12,575.75	7,432.62	5,143.13	69.20%
长期待摊费用	654.62	868.90	-214.28	-24.66%
递延所得税资产	6,355.56	4,694.03	1,661.53	35.40%
其他非流动资产	41,493.77	5,302.80	36,190.98	682.49%
非流动资产合计	340,743.54	296,097.58	44,645.96	15.08%
资产合计	637,534.63	475,745.98	161,788.66	34.01%

【增减变动幅度较大的项目分析】

货币资金期末较上年末增加 96,661.44 万元，增长比例 146.79%，主要系子公司金瑞泓微电子增资扩股吸收少数股东投资 120,000.00 万元尚未完全投入使用所致；

应收票据期末较上年末增加 924.57 万元，增长比例 64.6%，主要系本期收到的银行主体信用评级较低的银行承兑票据增加所致；

应收账款期末较上年末增加 12,766.61 万元，增长比例 30.94%，主要系本期销售增加所致；

预付款项期末较上年末增加 2,087.92 万元，增长比例 268.23%，主要系本期销售增加相应增加材料备货所致；

其他应收款期末较上年末减少 818.38 万元，减少比例 49.49%，主要系本期押金保证金退回所致；

其他流动资产期末较上年末减少 5,782.04 万元，减少比例 37.24%，主要系子公司金瑞泓微电子增值税留底税额退税导致待抵扣进项税额减少所致；

在建工程期末较上年末减少 44,674.56 万元，减少比例 74.02%，主要系本期子公司金瑞泓微电子年产 180 万片集成电路用 12 英寸硅片项目达到预定可使用状态转固所致；

无形资产期末较上年末增加 5,143.13 万元，增长比例 69.2%，主要系子公司金瑞泓微电子为构建员工宿舍购买土地使用权所致；

递延所得税资产期末较上年末增加 1,661.53 万元，增长比例 35.4%，主要系子公司金瑞泓微电子政府补助增加引起的企业所得税可抵扣暂时性差异增加所致；

其他非流动资产期末较上年末增加 36,190.98 万元，增长比例 682.49%，主要系本期子公司金瑞泓微电子年产 180 万片集成电路用 12 英寸硅片项目预付设备工程款增加所致；

2、负债构成及变动情况

单位：万元人民币

项目	2020 年末	2019 年末	变动额	增减变动比率
短期借款	119,555.61	117,310.37	2,245.24	1.91%
应付票据	5,183.14	5,153.23	29.91	0.58%
应付账款	25,827.71	33,928.90	-8,101.19	-23.88%
预收款项		214.71	-	-
合同负债	463.64		-	-
应付职工薪酬	3,721.91	3,440.59	281.32	8.18%
应交税费	3,471.82	2,441.32	1,030.50	42.21%
其他应付款	344.62	1,244.62	-900.00	-72.31%
一年内到期的非流动负债	3,507.55	3,675.86	-168.31	-4.58%
其他流动负债	123.36	5.65	117.71	2081.54%
流动负债合计	162,199.36	167,415.27	-5,215.90	-3.12%
长期借款	44,222.91	50,201.69	-5,978.78	-11.91%
长期应付款	166,990.49	52,598.10	114,392.39	217.48%
递延收益	12,852.52	9,624.55	3,227.97	33.54%
非流动负债合计	224,065.91	112,424.34	111,641.57	99.30%
负债合计	386,265.28	279,839.61	106,425.67	38.03%

【增减变动幅度较大的项目分析】

应交税费期末较上年末增加 1,030.5 万元，增长比例 42.21%，主要系本期销售收入和利润总额增加所致；

其他应付款期末较上年末减少 900 万元，减少比例 72.31%，主要系本期应付暂收款减少所致；

其他流动负债期末较上年末增加 117.71 万元，增长比例 2081.54%，主要系本期待转销项税额增加所致；

长期应付款期末较上年末增加 114,392.39 万元，增长比例 217.48%，主要系子公司金瑞泓微电子本期增资扩股吸收少数股东投资，根据协议安排确认远期

收购义务所致；

递延收益期末较上年末增加 3,227.97 万元，增长比例 33.54%，主要系本期收到的政府补助增加所致；

3、股东权益情况

单位：万元人民币

项目	2020 年末	2019 年末	变动额	增减变动比率
股本	40,058.00	36,000.00	4,058.00	11.27%
资本公积	72,623.79	60,934.94	11,688.85	19.18%
盈余公积	5,271.69	4,604.15	667.54	14.50%
未分配利润	67,579.38	49,851.16	17,728.23	35.56%
归属于母公司所有者权益	185,532.86	151,390.24	34,142.62	22.55%
少数股东权益	65,736.50	44,516.13	21,220.37	47.67%
所有者权益合计	251,269.35	195,906.37	55,362.99	28.26%

【增减变动幅度较大的项目分析】

未分配利润期末较上年末增加 17,728.23 万元，增长比例 35.56%，主要系当年经营净利润增加所致；

少数股东权益期末较上年末增加 21,220.37 万元，增长比例 47.67%，主要系本期子公司金瑞泓微电子增资扩股吸收少数股东投资增加所致；

4、现金流量情况

单位：万元人民币

项目	2020 年末	2019 年末	变动额	增减变动比率
经营活动现金流入小计	100,916.41	121,493.90	-20,577.50	-16.94%
经营活动现金流出小计	69,919.07	83,160.89	-13,241.83	-15.92%
经营活动产生的现金流量净额	30,997.34	38,333.01	-7,335.67	-19.14%
投资活动现金流入小计	1,135.27	-	-	-
投资活动现金流出小计	71,589.43	108,410.37	-36,820.94	-33.96%
投资活动产生的现金流量净额	-70,454.16	-108,410.37	37,956.21	-35.01%
筹资活动现金流入小计	303,296.19	223,468.29	79,827.91	35.72%
筹资活动现金流出小计	158,339.17	184,316.56	-25,977.38	-14.09%
筹资活动产生的现金流量净额	144,957.02	39,151.73	105,805.29	270.24%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-274.40	-485.18	210.78	-43.44%
现金及现金等价物净增加额	105,225.81	-31,410.81	136,636.62	-435.00%

【增减变动幅度较大的项目分析】

投资活动现金流出小计期末较上年末减少 36,820.94 万元，减少比例 33.96%，主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金相比去年同期减少所致；

筹资活动现金流入小计期末较上年末增加 79,827.91 万元,增长比例 35.72%,主要系子公司金瑞泓微电子增资扩股吸收少数股东投资 120,000.00 万元所致;

汇率变动对现金及现金等价物的影响期末较上年末增加 210.78 万元,增长比例 43.44%,主要系汇率变动所致;

5、经营情况

单位: 万元人民币

项目	2020 年末	2019 年末	变动额	增减变动比率
营业收入	150,201.78	119,168.60	31,033.18	26.04%
营业成本	97,188.82	74,701.84	22,486.98	30.10%
税金及附加	1,657.65	1,562.34	95.31	6.10%
销售费用	937.27	1,025.08	-87.81	-8.57%
管理费用	5,687.41	5,162.60	524.81	10.17%
研发费用	11,226.29	9,699.32	1,526.97	15.74%
财务费用	9,444.40	8,992.84	451.56	5.02%
其他收益	6,081.45	4,517.19	1,564.26	34.63%
投资收益	-	9.83	-9.83	-100.00%
公允价值变动收益	-	-	-	-
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-626.52	-548.89	-77.63	14.14%
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-5,712.23	-4,612.79	-1,099.45	23.83%
资产处置收益(损失以“-”号填列)	112.91	-	112.91	-
营业利润	23,915.55	17,389.92	6,525.64	37.53%
营业外收入	282.63	328.68	-46.05	-14.01%
营业外支出	275.51	123.87	151.65	122.43%
利润总额	23,922.67	17,594.73	6,327.94	35.96%
所得税费用	2,395.57	2,474.40	-78.82	-3.19%
净利润	21,527.09	15,120.33	6,406.76	42.37%
归属于母公司所有者的净利润	20,195.77	12,818.79	7,376.98	57.55%

【增减变动幅度较大的项目分析】

营业成本期末较上年末增加 22,486.98 万元,增长比例 30.1%,主要系衢州 8 英寸硅片项目 2020 年上半年产能利用率不足,固定成本较高,另外衢州 12 英寸硅片项目还处于产能建设和小批量生产阶段,固定成本过高所致;

其他收益期末较上年末增加 1,564.26 万元,增长比例 34.63%,主要系本期政府补助增加所致;

营业利润期末较上年末增加 6,525.64 万元,增长比例 37.53%,主要系本期主营业务收入增加所致;

营业外支出期末较上年末增加 151.65 万元,增长比例 122.43%,主要系本

期资产报废增加所致；

以上议案，请予审议。

附件一：《杭州立昂微电子股份有限公司2020年度审计报告》（中汇会审[2021]1515号）

附件二：《对杭州立昂微电子股份有限公司控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明》中汇会专[2021]1566号

五、关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案

报告人 吴能云

各位股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称“企业内部控制规范体系”),结合杭州立昂微电子股份有限公司(以下简称“公司”)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司 2020 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。自我评价结果如下:

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

具体内容详见附件一、二。

以上议案,请予审议。

附件一:《杭州立昂微电子股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》

附件二:《关于杭州立昂微电子股份有限公司内部控制的鉴证报告》(中汇会审[2021]1568号)

六、关于公司 2020 年度利润分配预案的议案

报告人 吴能云

各位股东：

现在我向大家报告公司 2020 年度利润分配预案及有关说明。

一、2020 年度利润分配预案内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现营业收入 1,502,017,793.75 元，合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 201,957,668.83 元，母公司实现净利润 66,754,068.43 元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，以母公司 2020 年度净利润为基数提取 10% 的盈余公积 6,675,406.84 元，连同上年末的未分配利润 143,881,478.24 元、扣除 2020 年已实施的 2019 年度利润分配 18,000,000.00 元，截至 2020 年 12 月 31 日母公司可供分配的未分配利润为 185,960,139.83 元。

综合考虑公司后续发展需要及股东回报，公司拟定 2020 年度利润分配预案如下：以 2020 年 12 月 31 日公司股份总数 400,580,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发 1.10 元现金红利（含税），共计派发现金红利 44,063,800.00 元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 21.82%，剩余未分配利润 141,896,339.83 元结转至以后年度分配。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

在股东大会审议通过的前提下，提请股东大会授权董事会办理现金分红相关事宜。

二、2020 年度现金分红比例低于 30% 的情况说明

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 201,957,668.83 元，母公司实现净利润 66,754,068.43 元。公司拟分配的现金红利总额预计为 44,063,800.00

元，占公司本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因分项说明如下。

（一）公司所处行业情况及特点

公司主营业务主要分三大板块：半导体硅片、半导体功率器件、化合物半导体射频芯片。主要产品包括 6-12 英寸半导体硅抛光片和硅外延片、6 英寸肖特基芯片和 MOSFET 芯片、6 英寸化合物半导体射频芯片等三大类。产品的应用广泛，主要的应用领域包括通信、计算机、汽车、消费电子、光伏、智能电网、医疗电子以及 5G、物联网、工业控制、航空航天等产业。

公司主营的三大业务板块具有技术复杂、生产流程长和制造工序多的特点，制造工艺复杂、技术壁垒高，需要投入大量资金购置先进研发、生产和检测设备。为保持产品的持续竞争力，企业必须不断对生产设备和工艺进行升级改造，并保持较高的研发投入，以紧跟行业技术更迭步伐。公司主营的三大业务板块都属于技术和资本密集型行业，需要大量资金进行设备等资本投入以实现生产规模的扩大，同时需要充足的现金流以满足日常经营和技术研发的需求。

（二）上市公司所处的发展阶段

公司目前正处于快速扩张的阶段。为抓住 5G 移动通信、汽车电子等产业的发展机遇，增强公司资本实力，补充公司业务发展所需资金，丰富公司产品类型，提高生产能力，更好地增强公司营运能力，提升盈利水平，进一步夯实公司在行业中的市场地位，公司于 2021 年 3 月 12 日公告了再融资项目的预案，拟发行募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 520,000 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于“年产 180 万片集成电路用 12 英寸硅片”、“年产 72 万片 6 英寸功率半导体芯片技术改造项目”、“年产 240 万片 6 英寸硅外延片技术改造项目”三个生产项目及补充流动资金，详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）上的公告（编号 2021-008）。

（三）上市公司盈利水平及资金需求

依托公司衢州半导体硅片生产基地上马，以及宁波半导体硅片生产基地、杭州半导体功率器件生产基地的技改升级、技术研发等持续投入，公司近几年实现了稳定、健康的发展，生产规模得到较为快速的扩张。

项目	2020 年	2019 年	2018 年
----	--------	--------	--------

营业收入（元）	1, 502, 017, 793. 75	1, 191, 685, 953. 89	1, 222, 666, 990. 31
归属于上市公司股东的净利润（元）	201, 957, 668. 83	128, 187, 904. 69	180, 759, 755. 45

公司决定及正在实施中的“年产 180 万片集成电路用 12 英寸硅片”、“年产 72 万片 6 英寸功率半导体芯片技术改造项目”、“年产 240 万片 6 英寸硅外延片技术改造项目”三个项目预算需要投入资金 492,365 万元，资金需求量大。

（四）上市公司现金分红水平较低的原因

公司非常重视投资者回报，现金分红比例严格按照《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》、《公司章程》关于现金分红比例的要求进行。

由于公司决定及正在实施中的“年产 180 万片集成电路用 12 英寸硅片”、“年产 72 万片 6 英寸功率半导体芯片技术改造项目”、“年产 240 万片 6 英寸硅外延片技术改造项目”三个项目预算需要投入资金 492,365 万元，2021 年有重大资金支出安排。

按照《公司章程》第一百五十三条“公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%”的规定，公司目前正处于快速扩张的阶段，且 2021 年有重大资金支出安排，因此确定了 2020 年度的现金分红比例为 21.82%，以确保公司的短期稳健和长远发展。

（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存的未分配利润，主要用于新项目固定资产投资、产线升级改造、新产品和新技术的研发等。公司决定及正在实施中的“年产 180 万片集成电路用 12 英寸硅片”、“年产 72 万片 6 英寸功率半导体芯片技术改造项目”、“年产 240 万片 6 英寸硅外延片技术改造项目”三个项目建成达产后，预计每年可实现不含税销售收入 247,710 万元，每年新增税后利润 43,123 万元。

以上议案，请予审议。

七、关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 的议案

报告人 吴能云

各位股东：

根据中国证监会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）与《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）的要求，公司针对2020年度募集资金的使用情况，编制了《杭州立昂微电子股份有限公司关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》，具体内容详见附件。

以上议案，请予审议。

附件一：《杭州立昂微电子股份有限公司关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》

附件二：《关于杭州立昂微电子股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》（中汇会鉴[2021]1567号）

八、关于 2020 年度公司董事、监事薪酬的议案

报告人 吴能云

各位股东：

2020 年度第三届董事会三名独立董事蔡晓虹先生、宋寒斌先生、余学功先生各自领取的独立董事津贴为 6 万元（税后）。

2020 年度第三届监事会主席陈卫忠先生领取监事会主席报酬 14.30 万元，第三届监事郑蓉领取的监事津贴为 6 万元（税后）。

2020 年度除以上人员外其他董事、监事未在本公司领取董事、监事报酬。

（说明：在 2020 年度，董事长王敏文先生，担任控股子公司浙江金瑞泓科技股份有限公司董事长，未在本公司领取董事报酬，其报酬由浙江金瑞泓科技股份有限公司发放，共计 43.50 万元；副董事长陈平人先生，担任控股子公司浙江金瑞泓科技有限公司总经理，未在本公司领取董事报酬，其报酬由浙江金瑞泓科技股份有限公司发放，共计 120.83 万元；董事刘晓健先生，担任本公司总经理，未在本公司领取董事报酬，领取总经理报酬 63.27 万元；董事吴能云先生，担任控股子公司浙江金瑞泓科技股份有限公司副总经理，未在本公司领取董事报酬，其报酬由浙江金瑞泓科技股份有限公司发放，共计 62.25 万元；监事周诗雨先生，担任本公司市场总监，未在本公司领取监事报酬，领取总监职务报酬 31.18 万元。）

（以上薪酬未注明者均为含税金额。）

以上议案，请予审议。

九、关于公司及子公司 2021 年度申请银行贷款授信额度的议案

报告人 吴能云

各位股东：

根据公司发展计划，为满足公司日常经营资金需要，公司及控股子公司 2021 年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币 20 亿元的贷款综合授信额度，上述授信包含原有额度的展期或续约及新增额度，综合授信品种包括但不限于：流动资金借款、信用证、银行承兑汇票、票据质押等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以公司及控股子公司与金融机构实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

以上议案，请予审议。

十、关于公司 2021 年度为控股子公司的银行授信提供担保的议案

报告人 吴能云

各位股东：

为保证控股子公司的生产经营对资金的需求，2021 年度公司需要对控股子公司的银行授信提供担保，具体如下：

1、控股子公司浙江金瑞泓科技股份有限公司向国家开发银行宁波市分行申请综合授信额度人民币 20,000 万元，具体借款金额、借款期限以实际签订的融资合同为准。本公司为其提供人民币 20,000 万元保证担保，担保期限以实际签订的担保合同为准，担保方式为连带责任保证。

2、控股子公司浙江金瑞泓科技股份有限公司向上海浦东发展银行宁波分行申请综合授信额度人民币 20,000 万元，具体借款金额、借款期限以签订的融资合同为准。本公司为其提供 20,000 万元保证担保，担保期限以实际签订的担保合同为准，担保方式为连带责任保证。

3、控股子公司浙江金瑞泓科技股份有限公司向中国建设银行宁波江北支行申请综合授信额度人民币 3,100 万元，具体借款金额、借款期限以签订的融资合同为准。本公司为其提供 3,100 万元保证担保，担保期限以实际签订的担保合同为准，担保方式为连带责任保证。

4、控股子公司浙江金瑞泓科技股份有限公司向广发银行宁波分行申请综合授信额度人民币 10,000 万元，具体借款金额、借款期限以签订的融资合同为准。本公司为其提供 10,000 万元保证担保，担保期限以实际签订的担保合同为准，担保方式为连带责任保证。

以上议案，请予审议。

十一、关于续聘 2021 年度审计机构的议案

报告人 吴能云

各位股东：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计服务机构，在多年的审计服务过程中，表现出较高的职业素养与执业水平，能独立、客观、公允地履行审计义务，出具的各项报告能客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司（含下属子公司）2021 年度审计机构。

相关审计费用提请股东大会授权公司董事会、经营班子与其签订业务合同，根据 2021 年度审计的具体工作量及市场水平，协商确定其年度审计费用。

以上议案，请予审议。